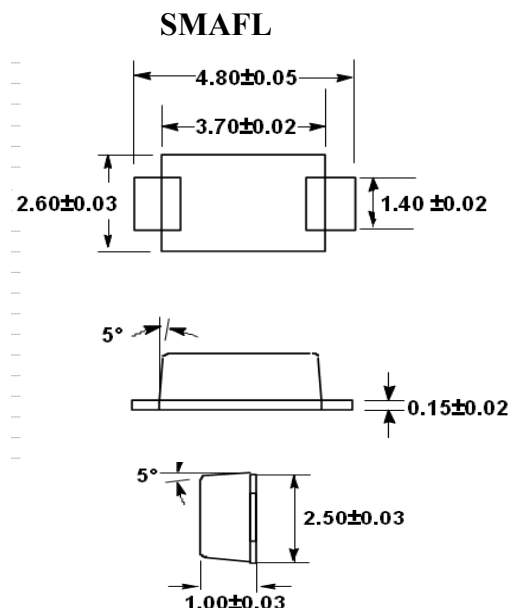


### 特性：

- ◆ 用于表面贴装
- ◆ 低正向压降
- ◆ 大电流导通能力
- ◆ 高可靠性
- ◆ 玻璃钝化芯片、晶粒尺寸 38mil
- ◆ 耐焊接热：250°C/10S，引出端 1.5mm 处。

### 机械性能：

- ◆ 封装：模塑封装
- ◆ 封装材料：采用 UL94V-0 认可的阻燃环氧料
- ◆ 极性：色带表示阴极
- ◆ 安装位置：任意



## 最大额定值及电气特性

测量环境温度为 25°C，除非另有规定。单相半波，50HZ，阻性或感性负载。  
对于容性负载，电流降额 20%。

型号	符号	M1F	M2F	M3F	M4F	M5F	M6F	M7F	单位
最大重复峰值反向电压	$V_{RRM}$	50	100	200	400	600	800	1000	V
最大平均有效值电压	$V_{RMS}$	35	70	140	280	420	560	700	V
最大直流截止电压	$V_{DC}$	50	100	200	400	600	800	1000	V
最大平均正向整流电流 $T_a=25^\circ\text{C}$	$I_F$ (AV)	1.0							A
峰值正向浪涌电流, 额定负载下, 单相正弦半波 10 毫秒 (JEDEC 方法)	$I_{FSM}$	15							A
最大瞬间正向电压@1.0A	$V_F$	1.1							V
最大反向直流电流 $T_a = 25^\circ\text{C}$ $T_a = 125^\circ\text{C}$ @ 额定直流截止电压 ( $V_R=V_{DC}$ )	$I_R$	5.0 50							$\mu\text{A}$
典型结电容 (注释 1)	$C_J$	30							PF
典型热阻 (注释 2)	$R_{\theta}$ (JA)	50							$^\circ\text{C} / \text{W}$
使用及储存温度范围	$T_J, T_{STG}$	-65 ~ +175							$^\circ\text{C}$

- 注释：
1. 在 1MHz 下测量，施加 4.0V d.c 的反向电压。
  2. 热阻是指从结至安装铜垫片端点的热阻，铜垫片面积 5×5mm。

## RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES

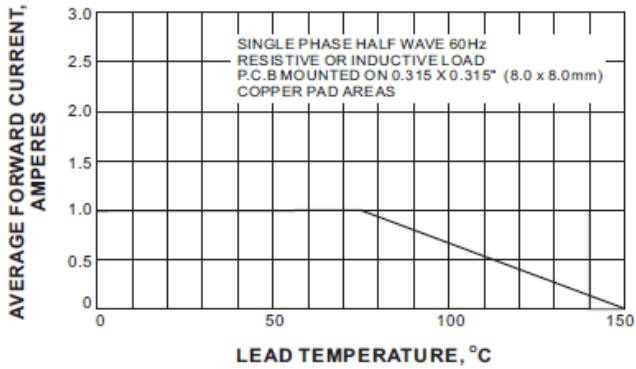


Fig.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE

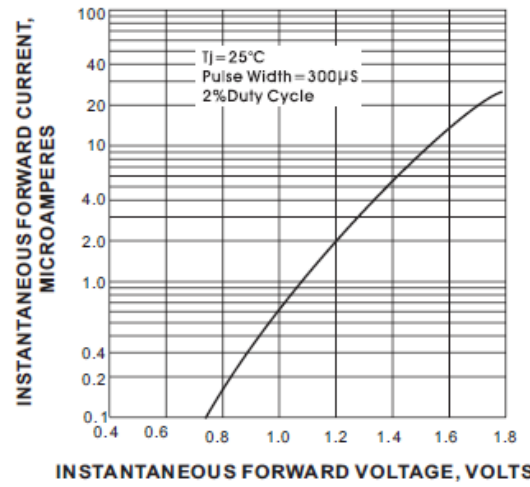


Fig.2-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

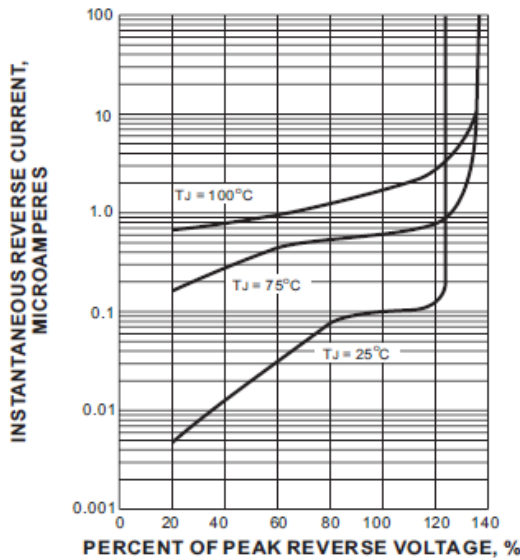


Fig.3-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

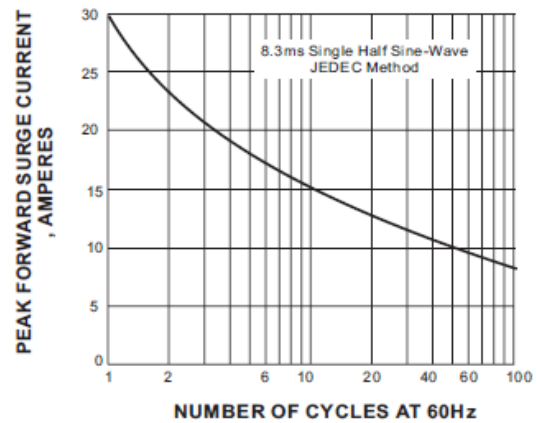


Fig.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

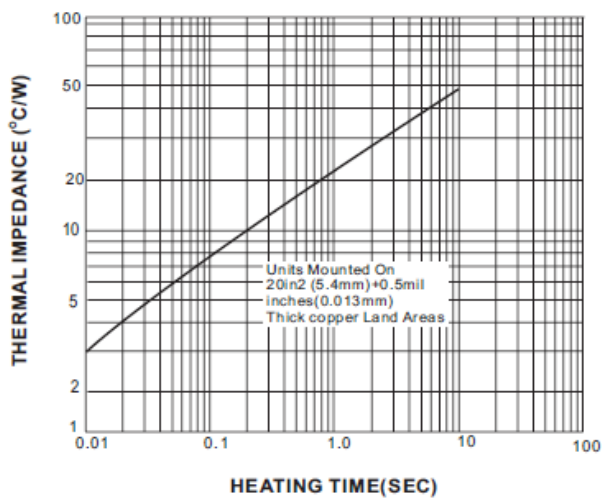


Fig.5-TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE

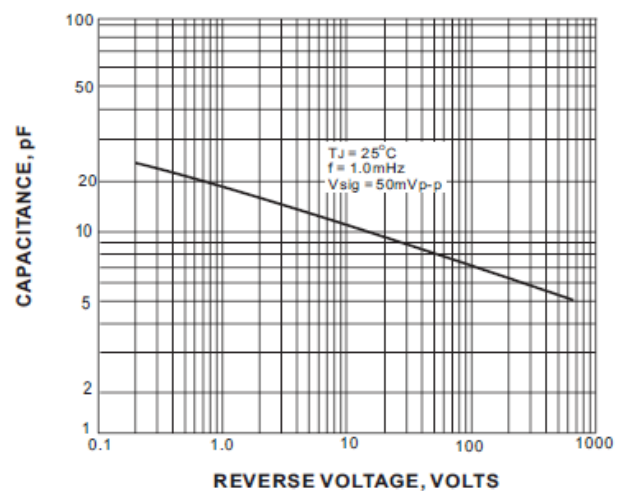


Fig.6-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE